

第 5 回 SiC 研究会個別討論会

テーマ『6インチ基板をターゲットに、加工技術の課題を掘り下げる』

主催: 社団法人応用物理学会 SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会

日時: 2010年7月30日(金) 10:00~17:00

会場: ウィンクあいち 1204会議室

<http://www.winc-aichi.jp/>

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

TEL: 052-571-6131



定員: 約50名 (事前登録制)

定員を超えた場合は人数調整あり

会費: 1000円(概要集、珈琲ブレイク代含む)

条件: 討論に全員参加。主テーマ(基板加工)に関し①課題や問題、②研究成果、③要求品質、等を提供しつつ討論に参加すること。可能であればパワーポイントファイル1枚程度に纏めてその場で登壇・話題提供をお願い致します。

詳細: <http://annex.jsap.or.jp/scrm/>

申込み: メールにて国立大学法人名古屋工業大学 江龍まで eryu.osamu@nitech.ac.jp

討論のネタまたは議論したい内容を50字~100字で書き添える。

締切り: 2010年7月9日(金)

***** プログラム *****

10:00-10:05 はじめに -討論会のねらいと議論の進め方- 企画責任者 江龍 修 (名古屋工業大学)

10:05-12:05 **基板加工の現状と課題** (座長: アクト 岡本、名古屋工業大学 江龍)

講演 各 30 分、質疑応答 30 分

1: 「ウエハ製造における現状と課題」(6インチ化の可能性も含めて: 国プロに向けて)

(株式会社デンソー)

2: 「基板研磨加工における研磨剤開発と課題」-Si加工の経験を踏まえて-

(株式会社フジインコーポレーテッド)

12:05-13:00 (昼食)

13:00-13:50

3: 「大型基板加工の現状と SiC 基板大型化加工の問題点抽出」

(株式会社 齊藤光学製作所)

13:50-15:00 パネルディスカッション（進行 齊藤光学製作所社長 齊藤、名工大 江龍）

『 6 インチインゴットが本当に出てきたら基板加工出来るのか？その可能性は？』

加工機：株式会社エム・イー・ティ、基板キャリア：日邦産業株式会社

研磨パッド：ポパール興業株式会社、ワイヤソー加工：株式会社 齊藤光学製作所

加工機：MAT、キャリア：日邦産業、パッド：ポパール興業、ワイヤソー加工：株式会社 齊藤光学製

研磨剤：株式会社フジミンコーポレーテッド、評価：ローム株式会社

15:00-15:15（休憩・コーヒブレーク）

15:15-15:55

4：「SiC 加工の新しい試みと GaN 研磨加工」

（名古屋工業大学）

15:55-16:55

5：「残された課題－実装におけるウエハ加工の期待－」

（株式会社デンソー）

16:55-17:00 おわりに SiC 研究会 委員長 伊藤久義（日本原子力研究開発機構）

***** 以上 *****

第5回SiC研究会個別討論会世話人

名古屋工業大学 江龍 修 (eryu.osamu@nitech.ac.jp)

電話：052-735-5447

株式会社デンソー 恩田 正一 (sonda@rlab.denso.co.jp)

電話：0561-75-1008

株式会社デンソー 鶴田 和弘 (KAZUHIRO_TSURUTA@denso.co.jp)

電話：0561-75-1131